

Distributed by:

JAMECO[®]
ELECTRONICS

www.Jameco.com ♦ 1-800-831-4242

The content and copyrights of the attached
material are the property of its owner.

Jameco Part Number 2063515



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

製品名称 Product Name			製品型番 Material Number	
プラグ アッセンブリ Plug Assembly	嵌合高さ Stacking Height H=8,14mm	吸着カバー無し Without Cover	無鉛 LEAD FREE	5 3 5 5 1 - * * 7 7
		吸着カバー付き With Cover	無鉛 LEAD FREE	5 3 6 4 7 - * * * 9
	嵌合高さ Stacking Height H=9,15mm	吸着カバー無し Without Cover	無鉛 LEAD FREE	5 3 5 5 2 - * * * 6
		吸着カバー付き With Cover	無鉛 LEAD FREE	5 3 6 4 9 - * * 7 2
	嵌合高さ Stacking Height H=10,16mm	吸着カバー無し Without Cover	無鉛 LEAD FREE	5 3 5 5 3 - * * 7 7
		吸着カバー付き With Cover	無鉛 LEAD FREE	5 3 6 2 7 - * * 7 2

*** : 極数 (添付図面参照)

CKTS(Refer to the drawing)

- * * 6 8 : 吸着カバー無しエンボス梱包
EMBOSSED PACKAGING OF PRODUCT WITHOUT COVER
- * * 7 4 : 吸着カバー付きエンボス梱包
EMBOSSED PACKAGING OF PRODUCT WITH COVER
- * * 7 5 : 吸着カバー付きスティック梱包
STICK PACKAGING OF PRODUCT WITH COVER
- * * 7 6 : 吸着カバー無しトレイ梱包
TRAY PACKAGING OF PRODUCT WITHOUT COVER
5 3 5 5 1 - * * 7 7 のトレイ梱包品は、5 3 9 3 6 - * * 7 6 です。
- * * 7 8 : 吸着カバー無しエンボス梱包
EMBOSSED PACKAGING OF PRODUCT WITHOUT COVER
5 2 7 6 0 - * * 7 0 のエンボス梱包品は、5 4 9 1 4 - * * 7 8 です。
- * * 7 9 : 吸着カバー無しスティック梱包
STICK PACKAGING OF PRODUCT WITHOUT COVER
- * * 9 4 : 吸着カバー付きエンボス梱包
EMBOSSED PACKAGING OF PRODUCT WITH COVER

【3. 定格 RATINGS】

項目 Item	規格 Standard	
最大許容電圧 Rated Voltage (MAXIMUM)	100 V	[AC(実効値 rms)/DC]
最大許容電流 Rated Current (MAXIMUM)	0.5 A	
使用温度範囲 Ambient Temperature Range (Operating and Non-operating)	-55°C ~+85°C *1	

* 1 : 通電による温度上昇分を含む。
Including terminal temperature rise

REVISE ON PC ONLY		TITLE:	
E	SEE SHEET 1 OF 11	0.635 mm PITCH B TO B CONN. HOUSING ASSEMBLY -LEAD FREE- 製品仕様書	
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
DOCUMENT NUMBER PS-52760-015		FILE NAME PS52760015.doc	SHEET 2 OF 11



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

【4. 性能 PERFORMANCE】

4-1. 電気的性能 Electrical Performance

項目 Item		条件 Test Condition	嵌合高さ Stacking Height	規格 Requirement
4-1-1	接触抵抗 Contact Resistance	適合するコネクタを嵌合させ、開放電圧 20mV 以下、短絡電流 10mA以下にて測定する。 (JIS C5402 5.4) Mate applicable connectors, measure by dry circuit, 20mV MAXIMUM, 10mA MAXIMUM. (JIS C5402 5.4)	H= 4 - 7mm	40 milliohm MAXIMUM
			H= 8 -10mm	50 milliohm MAXIMUM
			H= 11 -13mm	60 milliohm MAXIMUM
			H= 14 -16mm	70 milliohm MAXIMUM
4-1-2	絶縁抵抗 Insulation Resistance	適合するコネクタを嵌合させ、隣接するターミナル間及びターミナル、アース間に、DC 250V を印加し測定する。 (JIS C5402 5.2/MIL-STD-202 試験法 302) Mate applicable connectors together and apply 250V DC between adjacent terminal and ground. (JIS C5402 5.2/MIL-STD-202 Method 302)	1000 Megohm MINIMUM	
4-1-3	耐電圧 Dielectric Strength	適合するコネクタを嵌合させ、隣接するターミナル間及びターミナル、アース間に、AC 250V (実効値) を 1分間 印加する。 (JIS C5402 5.1/MIL-STD-202 試験法 301) Mate applicable connectors, apply 250V AC for 1 minute between adjacent terminal or ground. (JIS C5402 5.1/MIL-STD-202 Method 301)	異常なきこと No Breakdown	

4-2. 機械的性能 Mechanical Performance

項目 Item		条件 Test Condition		規格 Requirement
4-2-1	挿入・抜去力 Insertion Force/ Withdrawal Force	毎分 25±3 mm の速さで挿入、 抜去を行う。	挿入力 Insertion Force	0.690N {70gf} / CIRCUIT MAXIMUM
		Insert and withdraw connectors, at a rate of 25±3mm/minute.	抜去力 Withdrawal Force	0.118N {12gf} / CIRCUIT MINIMUM

REVISE ON PC ONLY	
E	SEE SHEET 1 OF 11
REV.	DESCRIPTION

TITLE:
0.635 mm PITCH B TO B CONN.
HOUSING ASSEMBLY
-LEAD FREE- **製品仕様書**

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

DOCUMENT NUMBER PS-52760-015	FILE NAME PS52760015.doc	SHEET 3 OF 11
--	-----------------------------	------------------



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

項目 Item		条件 Test Condition	規格 Requirement	
4-2-2	ターミナル保持力 Terminal Pull-out Force	ハウジングに装着されたターミナルを 毎分 25±3mm の速さで引っ張る。 Apply axial pull out force on the terminal assembled in the housing at a rate of 25±3mm/ minute.	52883-**70 52883-**92 52760-**70 52885-**72 52837-**70 52901-**72 55091-**71 55091-**72 53481-**67 53481-**77 53625-**72 53551-**77 53647-***9 53552-***6 53649-**72 53553-**77 53627-**72	1.96 N { 0.2kgf } MINIMUM
			53623-**72 53475-**70 53643-**72	3.9 N { 0.4kgf } MINIMUM

4-3. その他 Environmental Performance and Others

項目 Item		条件 Test Condition	規格 Requirement	
4-3-1	繰返し挿抜 Repeated Mate / Un-mate	1分間に 10回以下の速さで挿入、抜去を 50回 繰返す。 When mate / un-mated up to 50 cycles repeatedly at a rate of 10 cycles / minute.	接触抵抗 Contact Resistance	初期規格値からの 変化量: 20 milliohm以下 Change from initial requirement : 20 milliohm MAXIMUM
4-3-2	温度上昇 Temperature Rise	適合するコネクタを嵌合させ、最大許容電流 を通電し、コネクタの温度上昇分を測定する。 (UL 498) Mate applicable connectors and measure the temperature rise of contact when the maximum AC rated current is passed. (UL 498)	温度上昇 Temperature Rise	30°C MAXIMUM

REVISE ON PC ONLY		TITLE:	
E	SEE SHEET 1 OF 11	0.635 mm PITCH B TO B CONN. HOUSING ASSEMBLY -LEAD FREE- 製品仕様書	
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	
DOCUMENT NUMBER PS-52760-015		FILE NAME PS52760015.doc	SHEET 4 OF 11



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

項目 Item		条件 Test Condition	規格 Requirement	
4-3-3	耐振動性 Vibration	DC 1mA 通電状態にて、嵌合軸を含む互いに垂直な3方向に掃引割合 10~55~10Hz/分、全振幅 1.5mm の振動を 各2時間 加える。 (MIL-STD-202試験法 201) Mate connectors and subject to the following vibration conditions, for a period of 2 hours in each of 3 mutually perpendicular axes, passing DC 1mA during the test. Amplitude : 1.5mm P-P Frequency : 10-55-10Hz (MIL-STD-202, Method 201)	外観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	初期規格値からの変化量: 20 milliohm以下 Change from initial requirement : 20 milliohm MAXIMUM
			瞬断 Discontinuity	0.1 microsecond MAXIMUM
4-3-4	耐衝撃性 Shock	DC 1mA 通電状態にて、嵌合軸を含む互いに垂直な 6方向 に、パルス幅 11ms 衝撃波形が正弦半波 490m/s ² {50G} の衝撃を 各3回 加える。 (JIS C60068-2-27/MIL-STD-202 試験法 213) Mate applicable connectors and subject to the following shock conditions. 3 times of shocks shall be applied for each 6 directions along 3 mutually perpendicular axes, passing DC 1mA current during the test. (Total of 18 shocks) Test pulse : Half Sine Peak value : 490m/s ² {50G} Duration : 11ms (JIS C60068-2-27/MIL-STD-202 Method 213)	外観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	初期規格値からの変化量: 20 milliohm以下 Change from initial requirement : 20 milliohm MAXIMUM
			瞬断 Discontinuity	0.1 microsecond MAXIMUM

REVISE ON PC ONLY		TITLE: 0.635 mm PITCH B TO B CONN. HOUSING ASSEMBLY -LEAD FREE- 製品仕様書	
E	SEE SHEET 1 OF 11		
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	
DOCUMENT NUMBER PS-52760-015		FILE NAME PS52760015.doc	SHEET 5 OF 11
EN-37-1(019)			



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

項目 Item		条件 Test Condition	規格 Requirement	
4-3-5	耐熱性 Heat Resistance	<p>適合するコネクタを嵌合させ、85±2°C の雰囲気中に 96時間 放置後取り出し、1~2時間 室温に放置する。 (JIS C60068-2-2/MIL-STD-202 試験法 108)</p> <p>Mate applicable connectors and expose to 85±2°C for 96 hours. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditioned at ambient room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements shall be performed. (JIS C60068-2-2/MIL-STD-202 Method 108)</p>	外観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	初期規格値からの 変化量: 20 milliohm以下 Change from initial requirement : 20 milliohm MAXIMUM
4-3-6	耐寒性 Cold Resistance	<p>適合するコネクタを嵌合させ、-55±3°C の雰囲気中に 96時間 放置後取り出し、1~2時間 室温に放置する。 (JIS C60068-2-1)</p> <p>Mate applicable connectors and expose to -55±3°C for 96 hours. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditioned at ambient room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements shall be performed. (JIS C60068-2-1)</p>	外観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	初期規格値からの 変化量: 20 milliohm以下 Change from initial requirement : 20 milliohm MAXIMUM

REVISE ON PC ONLY		TITLE:	
E	SEE SHEET 1 OF 11	0.635 mm PITCH B TO B CONN. HOUSING ASSEMBLY -LEAD FREE- 製品仕様書	
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	
DOCUMENT NUMBER PS-52760-015		FILE NAME PS52760015.doc	SHEET 6 OF 11
EN-37-1(019)			



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

項目 Item		条件 Test Condition	規格 Requirement	
4-3-7	耐湿性 Humidity	<p>適合するコネクタを嵌合させ、60±2°C、相対湿度 90~95% の雰囲気中に 96時間 放置後、取り出し、1~2時間 室温に放置する。 (JIS C60068-2-3/MIL-STD-202 試験法103)</p> <p>Mate applicable connectors and expose to 60±2°C, relative humidity 90 to 95% for 96 hours. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditioned at ambient room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements shall be performed. (JIS C60068-2-3/MIL-STD-202 Method 103)</p>	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	初期規格値からの 変化量: 20 milliohm以下 Change from initial requirement : 20 milliohm MAXIMUM
			耐 電 圧 Dielectric Strength	4-1-3項 満足のこと Must meet 4-1-3
			絶縁抵抗 Insulation Resistance	100 Megohm MINIMUM
4-3-8	温度サイクル Temperature Cycling	<p>適合するコネクタを嵌合させ、-55±3°C に 30分、+85±2°C に 30分、これを 1サイクルとし、5サイクル 繰り返す。但し、温度移行時間は、3分以内 とする。試験後 1~2時間 室温に放置する。 (JISC0025)</p> <p>Mate applicable connectors and subject to the following conditions for 5 cycles. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditioned at ambient room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements shall be performed. 1 cycle a) -55±3°C 30 minutes b) +85±2°C 30 minutes (Transit time shall be within 3 minutes) (JISC0025)</p>	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	初期規格値からの 変化量: 20 milliohm以下 Change from initial requirement : 20 milliohm MAXIMUM

REVISE ON PC ONLY		TITLE:	
E	SEE SHEET 1 OF 11	0.635 mm PITCH B TO B CONN. HOUSING ASSEMBLY -LEAD FREE- 製品仕様書	
		THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	
REV.	DESCRIPTION	FILE NAME	SHEET
	PS-52760-015	PS52760015.doc	7 OF 11
EN-37-1(019)			



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

項目 Item		条件 Test Condition	規格 Requirement	
4-3-9	塩水噴霧 Salt Spray	<p>適合するコネクタを嵌合させ、35±2°C にて、重量比 5±1% の塩水を 48±4時間 噴霧し、試験後常温で水洗いした後、室温で乾燥させる。 (JIS C60068-2-11/MIL-STD-202 試験法101)</p> <p>Mate applicable connectors and expose to the following salt mist conditions. Upon completion of the exposure period, salt deposits shall be removed by a gentle wash or dip in running water, after which the specified measurements shall be performed. NaCl solution Concentration: 5±1 % Spray time: 48±4 hours Ambient temperature:35±2°C (JIS C60068-2-11/MIL-STD-202 Method 101)</p>	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	初期規格値からの 変化量: 20 milliohm以下 Change from initial requirement : 20 milliohm MAXIMUM
4-3-10	亜硫酸ガス SO ₂ Gas	<p>適合するコネクタを嵌合させ、40±2°C にて、50±5ppm の亜硫酸ガス中に 24時間 放置する。 Mate applicable connectors and expose to 50±5ppm SO₂ gas, ambient temperature 40±2°C for 24 hours.</p>	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接触抵抗 Contact Resistance	初期規格値からの 変化量: 20 milliohm以下 Change from initial requirement : 20 milliohm MAXIMUM
4-3-11	半田付け性 Solder-ability	<p>端子先端より 0.5mm の位置まで 245±3°C の半田に 3±0.5秒 浸す。 Dip soldertails into the molten solder {held at 245±3°C} up to 0.5mm from the bottom of the housing for 3±0.5 seconds.</p>	濡れ性 Solder Wetting	浸漬面積の 95%以上 95% of immersed area must show no voids, pin holes

REVISE ON PC ONLY

E

SEE SHEET 1 OF 11

TITLE:

0.635 mm PITCH B TO B CONN.
HOUSING ASSEMBLY
-LEAD FREE-

製品仕様書

REV.

DESCRIPTION

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

DOCUMENT NUMBER

PS-52760-015

FILE NAME

PS52760015.doc

SHEET

8 OF 11

EN-37-1(019)



PRODUCT SPECIFICATION



LANGUAGE

JAPANESE
ENGLISH

項 目 Item		条 件 Test Condition	規 格 Requirement	
4-3-12	半田耐熱性 Resistance to Soldering Heat	(リフロー時) 第6項の条件にて、2回リフローを行う。 (When reflowing) Repeat paragraph 6, two times.	外 観 Appearance	端子ガタ 割れ等 異状無きこと No Damage
		(手半田) 端子先端より 0.5mm、金具先端より 0.5mm の位置まで 370~400°C の半田ゴテにて 最大5秒 加熱する。 (Soldering iron method) 0.5mm from terminal tip and fitting nail tip. Soldering time : 5 seconds MAX. Solder temperature : 370~400°C		

(): 参考規格 Reference Standard

{ }: 参考単位 Reference Unit

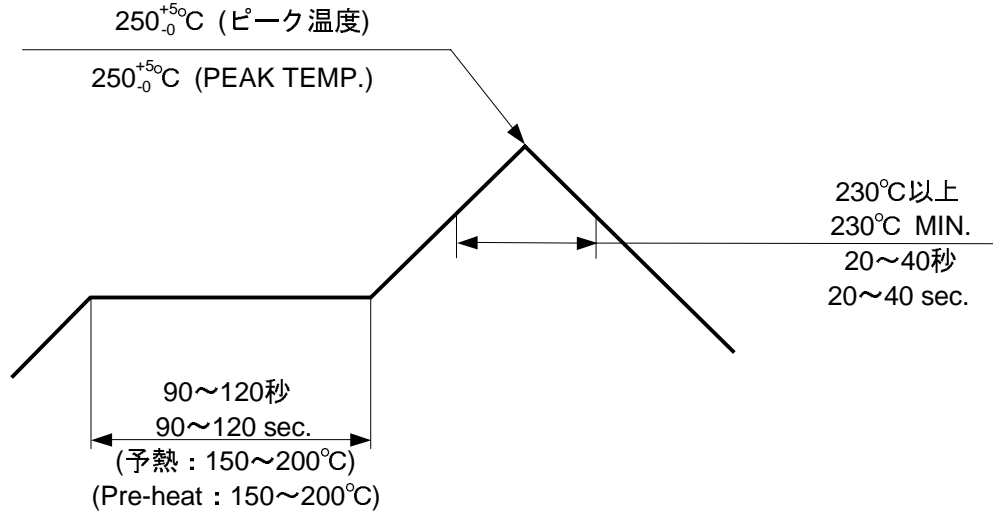
【5. 外観形状、寸法及び材質 PRODUCT SHAPE, DIMENSIONS AND MATERIALS】

図面参照 Refer to the drawing.

REVISE ON PC ONLY		TITLE:	
E	SEE SHEET 1 OF 11	0.635 mm PITCH B TO B CONN. HOUSING ASSEMBLY -LEAD FREE- 製品仕様書	
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	
DOCUMENT NUMBER PS-52760-015		FILE NAME PS52760015.doc	SHEET 9 OF 11
EN-37-1(019)			



【6. 赤外線リフロー条件 INFRARED REFLOW CONDITION】



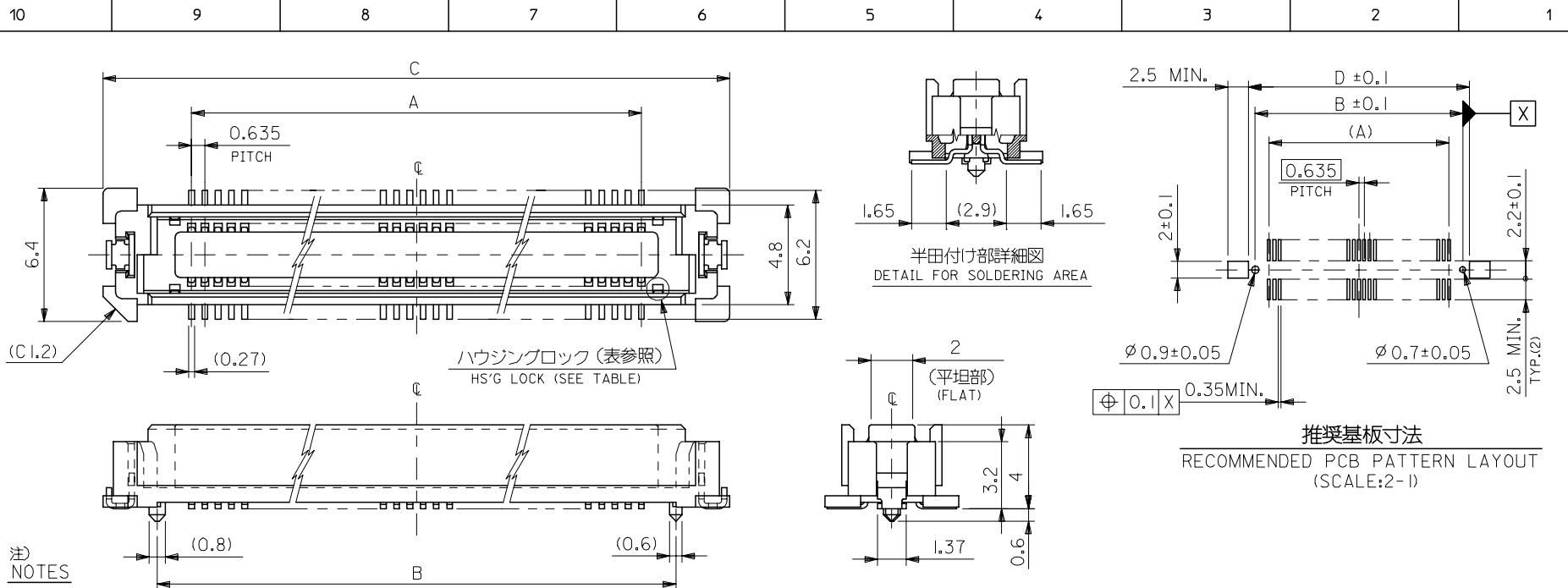
温度条件グラフ
(温度は基板パターン面)

TEMPERATURE CONDITION GRAPH
(TEMPERATURE ON THE SURFACE OF P.C.BOARD PATTERN)

注記 ; 本リフロー条件に関しては、リフロー装置及び基板などにより条件が異なりますので、事前にリフロー評価の確認をお願い致します。

NOTE ; Please check the reflow soldering condition by your own devices beforehand. Because the condition changes by the soldering devices, P.C.Boards, and so on.

REVISE ON PC ONLY		TITLE:	
E	SEE SHEET 1 OF 11	0.635 mm PITCH B TO B CONN. HOUSING ASSEMBLY -LEAD FREE- 製品仕様書	
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	
DOCUMENT NUMBER PS-52760-015		FILE NAME PS52760015.doc	SHEET 10 OF 11



注) NOTES

- 材質 MATERIAL
ハウジング : ガラス入りLCP, 白色, UL94V-0
HOUSING: LIQUID CRYSTAL POLYMER, GLASS FILLED, WHITE, UL94V-0
ターミナル : 銅合金 (t=0.2)
TERMINAL: COPPER ALLOY
補強金具 : 銅合金 (t=0.25)
FITTING NAIL: COPPER ALLOY
- メッキ仕様 PLATING
ターミナル: 接点部 : 金メッキ 0.25 μmMIN.
TERMINAL: CONTACT AREA: GOLD 0.25 MICROMETER MINIMUM
半田付け部 : 錫メッキ 2.0 μmMIN.
SOLDER TAIL AREA: TIN 2.0 MICROMETER MINIMUM
下地メッキ : ニッケルメッキ 2.0 μmMIN.
UNDER-PLATING: NICKEL 2.0 MICROMETER MINIMUM
補強金具: 錫メッキ 1.0 μmMIN.
FITTING NAIL: TIN 1.0 MICROMETER MINIMUM
下地メッキ : ニッケルメッキ 1.0 μmMIN.
UNDER-PLATING: NICKEL 1.0 MICROMETER MINIMUM
- テールのバラツキ寸法
TAIL COPLANARITY
テール及び金具の平坦度は、0.1以下とする。
TAIL AND FITTING NAIL COPLANARITY TO BE 0.1 MAXIMUM.
- エンボス対応済みの極数については、SD-52760-014を参照下さい。
FOR THE EMBOSSED PACKAGE PRODUCTS, SEE SD-52760-014.

5. 本製品は52760-***0の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52760-***0.

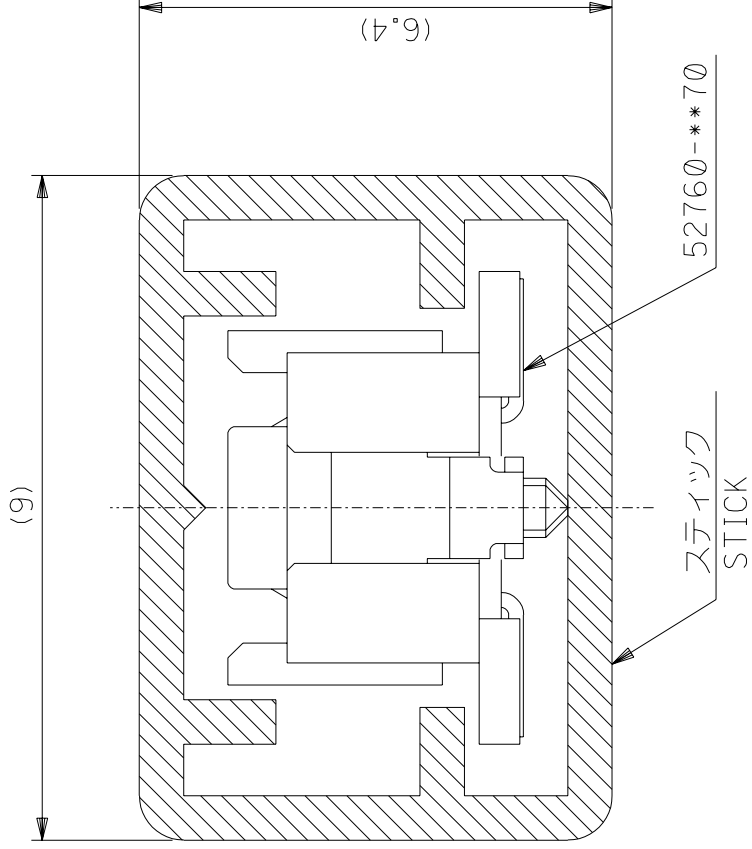
10 mm	53553 SERIES
9 mm	53552 SERIES
8 mm	53551 SERIES
7 mm	53481 SERIES
6 mm	53467 SERIES
5 mm	53475 SERIES
基板間寸法	嵌合相手
STACKING HEIGHT	TO BE MATED WITH

無し NO	80.47	84.07	78.87	75.565	→	52760-2479	52760-2470	240	—
	67.77	71.37	66.17	62.865	→	-2079	-2070	200	○
	61.42	65.02	59.82	56.515	→	-1879	-1870	180	○
	55.07	58.67	53.47	50.165	→	-1679	-1670	160	○
	48.72	52.32	47.12	43.815	→	-1479	-1470	140	○
	42.37	45.97	40.77	37.465	→	-1279	-1270	120	○
	36.02	39.62	34.42	31.115	52760-1078	-1079	-1070	100	○
	32.85	36.45	31.25	27.94	↑ -0978	-0979	-0970	90	○
	29.67	33.27	28.07	24.765	-0878	-0879	-0870	80	○
	26.5	30.1	24.9	21.59	-0778	-0779	-0770	70	○
有り YES	25.86	29.43	24.26	20.955	-6878	-6879	-6870	68	○
	23.32	26.92	21.72	18.415	-0678	-0679	-0670	60	○
	20.15	23.75	18.55	15.24	-0578	-0579	-0570	50	○
	16.97	20.57	15.37	12.065	-0478	-0479	-0470	40	○
13.8	17.4	12.2	8.89	↓ -0378	-0379	-0370	30	○	
10.62	14.22	9.02	5.715	52760-0278	52760-0279	52760-0270	20	○	
ハウジングロック HSG LOCK	D	C	B	A	エンボス梱包 EMBOSSED PACKAGING	スティック梱包 STICK PACKAGING	製品番号 MATERIAL NO.	極数 CKT. NO.	製造所 AVAILABLE

推奨基板寸法
RECOMMENDED PCB PATTERN LAYOUT
(SCALE:2-1)

REVISED EC NO: J2007-0439 DR: W/NABEI CHK: K/TYOODA APPR: NUKITA	2006/08/22	2006/08/25	2006/09/05	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNIT'S METRIC	MODEL NO. 52760-***70	THIRD ANGLE PROJECTION	
	10 UNDER	± 0.2	DRAWN BY Y. WADA		DATE '04/02/26	TITLE 0.635 PITCH B-T0-B S/T REC. HSG ASSY -LEAD FREE-		MOLEX MOLEX INCORPORATED					
	10 OVER 30 UNDER	± 0.25	CHECKED BY M. SASAO		DATE '04/02/26	APPROVED BY M. SASAO		DATE '04/02/26	DOCUMENT NO. SD-52760-013				
	30 OVER	± 0.3	APPROVED BY M. SASAO		DATE '04/02/26	MATERIAL NO. SEE CHART		DOCUMENT NO. SD-52760-013	SHEET NO. 1 OF 1				
	ANGULAR	± 3 °	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SIZE A3		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION						

DWG. NO. SD-52760-015



注) NOTES.

1. スティック両端はキャップ止め。
BOTH ENDS WITH CAPS.
2. 全長: 6.00±2
TOTAL LENGTH
3. 肉厚: 0.6±0.2
THICKNESS
4. 量産対応済の極数については、SD-52760-013を参照下さい。
SEE SD-52760-013 FOR AVAILABLE ITEMS.
5. 本製品は52760-015の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52760-015.

角度	ANGLE	±3°
30以上	OVER	±0.3
10以上	30未満	±0.25
10未満	OVER	±0.2
一般公差		
GENERAL TOLERANCES		

MODEL NO.	52760-015
材料	スティック: ポリ塩化ビニル STICK: P.V.C
仕上げ	—#—
適用電線範囲	—#—
被覆外径	—#—
INS. RANGE	—#—
DRAWN BY	'04/02/26 CHK'D BY '04/02/26
Y.W.	M.S
DR.	DATE
Y.W.	'04/02/26
DR.	DATE

材料	スティック: ポリ塩化ビニル STICK: P.V.C
仕上げ	—#—
適用電線範囲	—#—
被覆外径	—#—
INS. RANGE	—#—
DRAWN BY	'04/02/26 CHK'D BY '04/02/26
Y.W.	M.S
DR.	DATE
Y.W.	'04/02/26
DR.	DATE

梱包数	QUANTITY	極数	NO. OF CKT.
6	52760-2479	240	
7	-2079	200	
8	-1879	180	
9	-1679	160	
10	-1479	140	
12	-1279	120	
14	-1079	100	
15	-0979	90	
17	-0879	80	
18	-0779	70	
19	-6879	68	
21	-0679	60	
23	-0579	50	
27	-0479	40	
32	-0379	30	
39	52760-0279	20	
MATERIAL NO.	MATERIAL NO.		

REV	0
DWG. NO.	SD-52760-015
TITLE 名称	52760-015 STICK PACKAGING -LEAD FREE-
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING